

令和7年12月8日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム
半導体製造センシング・実装技術WG
主査 日下 靖之
副査 岩崎 渉、坂田 義太朗、竹井 裕介

令和7年度 第3回 半導体製造センシング・実装技術WGのご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのWG活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本WGでは、次世代パッケージング技術やその製造・検査等におけるスマートセンシング、インフォマティクス融合など、半導体製造センシング・実装技術に関し、情報共有と議論を通して技術開発要素の課題抽出やプロジェクト提案・実施を目指します。今回は、東京ビッグサイトで開催予定の第40回ネプコンジャパンの見学を企画しています。ご出席宜しくお願い致します。2026年1月7日(水)までに参加のご意向をご連絡いただけますと幸いです。

敬具

記

日時：2026年1月21日(水) 14:10～16:00 (17:30～懇親会)

会場：東京ビッグサイト

14:10	東京ビッグサイト 集合 ※集合場所は別途ご連絡いたします。 ※本WGにご参加の方におかれましては、WGへの申し込みに加え、展示会の来場登録の上、 入場バッジをご準備ください。
14:10～16:00	ネプコンジャパン見学 (産総研先端半導体研究センター 高橋総括研究主幹による案内)
17:30～	懇親会 ※新橋周辺を予定しております。参加希望の有無は申込時のアンケートでお答えください。

なお、翌日 1/22 には人・機械インタラクション WG にて Physical AI に関する講演会を企画しております。併せてご参加を検討賜れれば幸いです。

お問い合わせ先：半導体製造センシング・実装技術 WG 事務局
(国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内
E-mail: M-stri-SenTePack-smapack-ml@aist.go.jp